

证券代码：600105

公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-12-16

投资者关系活动类别	现场参观、分析师会议
参与单位名称	招商基金 嘉实基金 华安基金 长江资管 鹏华基金 中融基金 东方阿尔法 中银资管 相聚投资 财通资管 朱雀基金 中融基金 诺安基金 淡水泉 东吴自营 农银汇理 兴银基金 兴业基金 银河基金 运舟资本 磐泽 国联民生证券 华泰证券 易方达基金
时间	2025 年 12 月 16 日
地点/方式	公司会议室
上市公司参会接待人员	董事、副总经理、董事会秘书：张国栋 永鼎光电子集团董事长：李鑫 鼎芯研发总监：张金胜 投资者关系经理：房術
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司整体业务布局与战略方向</b> 永鼎股份以科技创新为核心驱动力，聚焦新质生产力培育，构建了“光电交融，协同发展”的战略产业格局。</p> <p><b>（一）光通信领域：全产业链覆盖，向高端器件延伸</b> 公司以“光棒-光纤-光缆”等网络基础通信产品为根基，纵向延伸布局光芯片、光器件、光模块等核心环节，形成从基础材料到终端应用的全链条能力。依托细分领域的全产业链优势，公司已实现从原材料制备到高端光电子器件的自主可控，深度参与全球光通信产业链分工。</p> <p><b>（二）电力传输领域：“一带一路”+新能源</b> 在电力系统领域，公司持续深化“一带一路”沿线海外电力工程布局，同步拓展新能源汽车线束业务，加速高温超导带材产能扩张。</p> <p><b>（三）核心能力建设：聚焦激光器芯片与超导带材两大核心赛道</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>光芯片领域：</b>完善激光器芯片产品矩阵，建成行业领先的化合物半导体工艺产线，技术覆盖芯片设计、晶体材料生长、晶圆工艺及测试封装全流程；采用 IDM（集成器件制造）模式，严格把控质量并执行高可靠性测试标准，确保产品性能稳定。</li><li><b>超导带材领域：</b>自主研发 IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD</li></ul>

	<p>（金属有机化合物化学气相沉积）技术路线的成套生产设备，掌握独有的重掺杂强磁通钉扎 <b>REBCO</b>（稀土钡铜氧）超导薄膜制备工艺，持续优化工艺参数并加速产能释放。</p> <p><b>二、光通信激光器芯片产品布局</b></p> <p>公司激光器芯片产品线覆盖多速率、多应用场景，主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EML 系列</b>：100G EML、56G EML；</li><li>• <b>硅光 DFB 系列</b>：100mW CW HP、70mW CW HP；</li><li>• <b>通信 DFB 系列</b>：25G DML、10G DML；</li><li>• <b>传感系列</b>：1653-TMT、1653-NTC；</li><li>• <b>窄线宽系列</b>：7XXnm 窄线宽激光器及其他定制化产品。</li></ul> <p><b>（一）AI 算力驱动的热门产品：800G/1.6T 光模块核心芯片</b></p> <p>当前市场关注度较高的产品为 <b>100G EML</b> 及 <b>硅光 100mW CW HP、70mW CW HP</b>，主要配套 800G、1.6T 光模块需求。受益于全球 AI 算力中心增长，相关芯片供需缺口扩大。公司旗下子公司鼎芯光电已实现上述产品的批量化生产能力，获国内某些光模块厂商认可，并建立合作。</p> <p><b>四、高温超导带材业务现状与市场策略</b></p> <p><b>（一）产品优势</b></p> <p>子公司东部超导专注第二代高温超导带材及应用产品开发，采用国内独有的 <b>IBAD+MOCVD</b> 技术路线，所制备的 <b>REBCO</b> 超导薄膜磁通钉扎性能优异。</p> <p><b>（二）客户合作与应用场景拓展</b></p> <p>产品已覆盖可控核聚变磁体、超导感应加热、磁拉单晶、医学等领域，并与相关客户机构建立合作。</p> <p><b>（三）市场前景与应对策略</b></p> <p>随着国家“十五五”规划将可控核聚变列为战略科技方向，叠加全球能源转型需求，超导带材应用场景持续丰富，未来市场景气度有望显著提升。为此，公司计划 2026 年持续扩产，匹配下游需求增长。</p> <p><b>五、高性能超导带材技术突破与产业化进展</b></p> <p>永鼎股份旗下东部超导推出的 <b>HF1200 系列高性能 REBCO 超导带材</b>，已实现单根千米级批量化制备（最大长度 1435 米）。经测试，在 20K/20T（垂直场 B<sub>IIc</sub>）条件下，4mm 带宽材临界电流 I<sub>c</sub> 达 435A，换算至 12mm 带宽后 I<sub>c</sub> 高达 1305A，这一突破标志着公司在强场应用领域的产业化能力迈入新阶段。该成果验证了 HF1200 系列带材优异的磁通钉扎性能与强场适应性，为其在磁约束可控核聚变等前沿领域的规模化应用提供了坚实支撑。</p> <p><b>总结：</b>永鼎股份通过“光通信+超导”双轮驱动，依托 IDM 模式与全产业链布局，在高端光芯片与超导带材领域构建了显著的技术壁垒与市场竞争力。未来，公司将持续加大研发投入与产能扩张，把握 AI 算力与可控核聚变等战略机遇，推动新质生产力加速落地。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------